

Схема для нормального построения многослойной печатной платы

Вакуумирование	20-30мин
Температура валиков	205-215 °C. Пиковая температура должна быть при 200 °C
Отверждение	>190с(температура материала) 80 мин для толщины основания 3,5 мм >190 °C (температура материала)-100 мин для толщины 3,5мм Для толщины 5 мм свяжитесь с службой технической помощи
Термостойкость	1,8-2,5°C /мин (от 80°C до 130 °C)
Давление	Давление в начале ламинирования 5 - 7 кгс/см ² в течение 20 мин Полное давление 25 ~ 32 кгс/см ² при температуре 90 ~ 110 °C Уменьшенное давление при 50% -60% этапа отверждения
Скорость охлаждения	< 2 ° C / мин, начиная с 190 ° C до 120 ° C
Время выдерживания	200 мин
Предупреждение	Это фактическое полное давление может отличаться от предложенной схемы . Давление и отверждение и продолжительность может зависеть от конструкции платы , а также других факторов.

EM-827(I) Dual Stage Press Cycle

